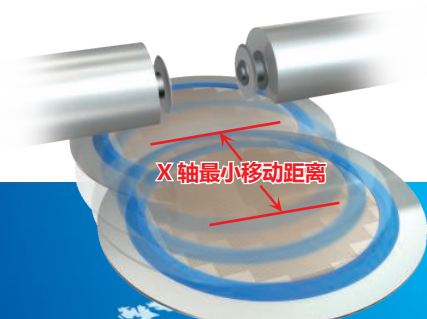


AD3000T-HC PLUS

快速, 精准, 创新



X轴最小移动距离

对向型双轴机

实现 WH/FH 自动切换

晶圆搬运和框架搬运可自动切换, 减少了切换中的风险, 使得机器停机时间大大减少。

占地面积非常小

本公司核心技术驱使
占地面积大大减小
是旧机型的 68%

快速高效的双轴切割机

X 轴 1000mm/s
Y 轴 300mm/s
加工速度快、使用成本低

标准搭载 FOUP opener

自动化操作从而减少了晶圆破损的风险,
封闭式的 FOUP 降低批次处理中的环境污染的风险

进化的 GUI 操作界面

在双轴机上搭载 GUI 技术
标准配置 HELP 功能



东京精密自 1970 年开发了第一台晶圆切割机 A-WD-75A 以来, 为高精度芯片分割和半导体产业开始时期的高效率化做出了很大的贡献。

继承开发当初的技术的基础上, 融合了最新的 Fluidics·

Mechatronics· Energy Conservation 技术的 AD3000T-HC PLUS,
正引领新的切割技术。

特征

- 1 WH/FH 自动切换**
晶圆搬运和框架搬运可自动切换,减少了切换中的风险,使得机器停机时间大大减少。
- 2 标准搭载 FOUNOP opener**
自动化操作从而减少了晶圆破损的风险,封闭式的 FOUNOP 降低 lot 处理中的环境污染的风险
- 3 标准搭载非接触式工件厚度感应器**
搭载 air micro 感应器,可测定工件等的厚度
- 4 选配单元的小型化,内部设计的优化,使得主要选配单元内藏成为可能。**
- 5 标准搭载 6 万转的主轴**
(8 万转选配可对应)
- 6 加工效率向上**
① X 轴速度 1000 mm/s, Y 轴速度 300 mm/s, Z 轴速度 80 mm/s
② 搭载 2 个光学式测高单元
③ 世界最小刀片间距
- 7 17 英寸触摸屏 + 新 GUI**
搭载了 GUI(用户操作界面)易于观察的画面和大型的按钮,在增强操作性的同时,采用了对话式的容易理解的输入方式
- 8 搭载了无需复杂的参数设定的刀痕检查功能**
(AI 刀痕检查功能)
- 9 硬盘内可存储和管理 10000 个以上的加工参数**
- 10 标准搭载 USB 接口**
(可以使用 USB 等外部存储设备)
- 11 维护性向上**
大型的前部维护门改善了维护性
- 12 切割台面内补正功能 (Active-Z)**
对切割台面内的不平整进行补正,实现高精度的切割高度控制

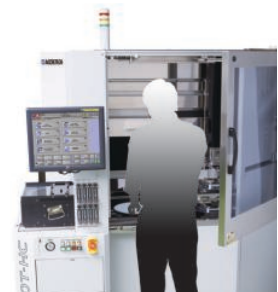


▲ 新 GUI

规格

最大工件尺寸	Φ 305 mm	
最大框架尺寸	12 英寸 (SEMI G74-0699)	
主轴	最高转速	60,000 min-1 80,000 min-1 (选配)
	最大刀片外径	Φ 60 mm (2-Inch) Φ 80 mm (3-Inch) (选配)
	输出功率	1.8 KW
X 轴	可切割范围	310 mm
	最高速度	1,000 mm/s
Y1/Y2 轴	可切割范围	310 mm
	最高速度	300 mm/s
	分辨率	0.078 μm
	精度	0.002 mm / 310 mm
Z1/Z2 轴	行程范围	35mm
	分辨率	0.002 μm
	最高速度	80 mm/sec
	重复精度	0.001 mm
θ 轴	旋转范围	380°
使用条件	电压	3 相 AC200 to 220± 10% (可使用变压器)
	功率	6.0 kVA (MAX)
	气压	0.55 ~ 0.7 MPa
	平均气体消耗量	210 L/min (0.55 MPa)
	平均洁净气体消耗量	140 L/min
	切割水和其他 (压力)	0.3 ~ 0.5 MPa
	切割水和其他 (最大流量)	切割水: 10.0 L/min 水帘: 3.0 L/min 其他: 0.6 L/min
	冷却水 (压力)	0.3 ~ 0.5 MPa
	冷却水 (最大流量)	3.4 L/min (0.3 MPa)
	排气量	5.0 m ³ /min 以上
尺寸 (W*D*H)	1,290 mm x 1,530 mm x 1,900 mm	
重量	1,360 kg	

维护



安装空间

AD3000T-HC PLUS 与旧机型相比,成功实现了小型化。

